

Oferta **TSka** umożliwia szybkie wykonanie wzorcowych płytek drukowanych na potrzeby prototypowania układów elektronicznych. Prototyp TSka pozwala wyeliminować ewentualne błędy projektu przed przystąpieniem do uruchomienia produkcji seryjnej oraz zminimalizować koszt przygotowania produkcyjnej dokumentacji technicznej.

PROTOTOTYP TSka – ZASADY REALIZACJI

Warunki realizacji oraz dostępna technologia:

Element	Specyfikacja techniczna	
	Obwody jedno- oraz dwuwarstwowe	Obwody 4-warstwowe
Powierzchnia	do 12 dm ²	
Terminy [dni robocze]	4 - ekspres 7 - standard	5 - ekspres 9 - standard
Laminat bazowy	FR4 (TG 140°C, CTI 175-249 V)	
Grubość laminatu bazowego [mm]	1,00* lub 1,55**	
Grubość miedzi końcowej	35 μm (wszystkie warstwy)	
Maska antylutownicza	zielona półmatowa: dwustronna, jednostronna lub brak	
Opis elementów	jednostronny (standard) dwustronny (dodatkowa dopłata)	
Obróbka mechaniczna	frezowanie; rylcowanie	
Typ pokrycia	cynowanie bezołowiowe (HAL), złocenie chemiczne (ENIG)	
Otwory	przelotowe (TOP – BOT): metalizowane (PTH) oraz niemetalizowane (NPTH)	
Minimalna średnica otworów metalizowanych [mm]	0,15 (tolerancja: + 0,1 / - 0,05)	
Testowanie	TAK (opcjonalne)	TAK (obowiązkowe)
Certyfikat UL	TAK (opcjonalny)	
Dopuszczalne szerokości oraz odległości elementów mozaik [mil]	warstwy zewnęt ≥ 4***	rzne warstwy wew ≥5

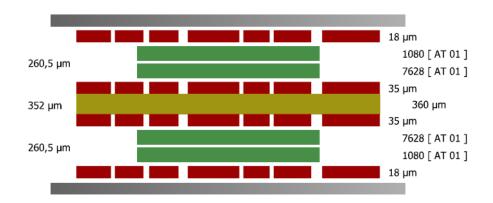
^{*} Stos warstw dla obwodów 4-warstwowych przedstawiono na rys. 1.

^{**} Stos warstw dla obwodów 4-warstwowych przedstawiono na rys. 2.

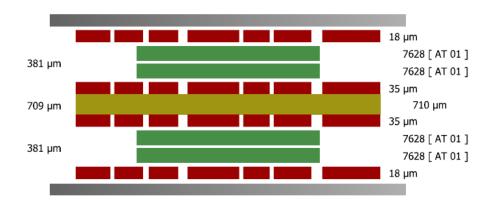
^{***} Dla szerokości/odległości 4 mils wymagane jest złocenie chemiczne



Stosy warstw dla obwodów 4-warstwowych



Rys. 1. Stos warstw dla laminatu bazowego o grubości 1,00 mm



Rys. 2. Stos warstw dla laminatu bazowego o grubości 1,55 mm

Przedstawione na rysunkach grubości odnoszą się do laminatu bazowego i nie uwzględniają grubości nakładanych powłok: miedzi galwanicznej, masek antylutowniczych, warstw opisowych oraz pokrycia.